

DIAPOL 509

RESINA PU FLEXIBLE
CLASE TÉRMICA: B (130°C)
POLIMERIZACIÓN AL AIRE

✓ Gran adherencia a distintos materiales

✓ Mantiene la flexibilidad a temperaturas bajo cero

CAMPO DE APLICACIÓN

Resina de colada bicomponente para múltiples aplicaciones eléctricas y electrónicas (ej.: reactancias, arrancadores, condensadores, canalizaciones, empalmes subterráneos, electroimanes, etc.).

MODO DE EMPLEO

Debe homogeneizarse antes de ser empleada y se puede mezclar con su catalizador a temperatura ambiente, según la dosificación 100/10 en peso. Para conseguir una mejor calidad en el acabado de la aplicación, recomendamos precalentar la resina a 50°C aprox. El empleo de máquinas mezcladoras-dosificadoras automáticas, favorece la manipulación de este producto. Si se desea desencapsular la resina polimerizada, se deberá aplicar nuestro agente desmoldeante en el molde. Para piezas encapsuladas donde se requiera presentar máximas características eléctricas recomendamos realizar la colada bajo vacío.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	DIAPOL 509	CATALIZADOR 500	MEZCLA 100/10
Viscosidad a 25°C (mPa.s)	12000 ± 2000	200 ± 50	10000± 2000
Densidad a 20°C (g/cm ³)	1.55 ± 0.04	1.23 ± 0.01	1.52 ± 0.02
Pot Life a 25°C (min)	120-140		
Polimerización total	10h. a 60°C		
Dureza Shore A	80		
Resistencia a la tracción (MPa)	1.8		
Alargamiento a la rotura (%)	10		
Absorción agua 24h,20°C (% peso)	0.1-0.2		
Rigidez dieléctrica, 50Hz,20°C (KV/mm)	15		
Resistencia superficial (Ohm)	n.d.		
Resistencia específica (Ohm.cm)	n.d.		
Constante dieléctrica, 50Hz, 20°C	4.2		
Resis. defor. térmica Pto. Martens (°C)	20		
Conductividad térmica (W/mK)	0.5-0.6		

FORMA DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

En bidones metálicos de 1, 5, 25, 140, 300 Kg y contenedores de 1000Kg.

Recomendamos la utilización del producto antes de 18 meses desde su fecha de fabricación. Debe conservarse en ambiente seco, a una temperatura entre 5 y 30°C, y correctamente cerrado en su embalaje original.

Rev. Septiembre 2022
Versión: 3

La información que les ofrecemos es de carácter informativo y como resultado de nuestros ensayos, pero sin asumir ninguna responsabilidad derivada de su aplicación.